

Pressemitteilung

InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik

Dresden, den 09.01.2023

Lock-In-Thermografie für Elektronik- und Halbleitermodulprüfung Thermische Auffälligkeiten und lokale Leistungsverluste innerhalb kürzester Prüfzeiten detektieren

Die Inspektion elektronischer Komponenten und Baugruppen mit Hilfe der Aktiv-Thermografie ist ein etabliertes Prüfverfahren zur Fehlersuche und Qualitätssicherung – von der Prototypen-Entwicklung bis hin zur Serienproduktion. Mit diesem äußerst empfindlichen Verfahren lassen sich atypische Temperaturverteilungen und Hotspots mit Variationen von wenigen Millikelvin an Oberflächen von Leiterplatten, integrierten Schaltkreisen und Multichip-Modulen zuverlässig berührungslos detektieren.

Die Lock-In-Thermografie liefert hoch detaillierte Informationen während eines jeden Entwicklungsschrittes. Diese können anschließend für das Design von komplexen elektronischen Schaltkreisen bzw. Baugruppen zur Optimierung des Wärmemanagements herangezogen werden. Insbesondere in der Elektronikproduktion wird die aktive Thermografie als vielseitiges Instrument eingesetzt: u. a. bei der Qualitätssicherung, zur permanenten Überwachung technologischer Parameter sowie zur Inline-Inspektion von Produkten in der Fertigung und zur abschließenden Qualitätskontrolle.

Bei der Lock-In-Thermografie werden durch die definierte elektrische Anregung eines elektronischen Bauteiles oder einer Baugruppe lokale Wärmequellen generiert. Diese Wärmequellen haben ihren Ursprung in regulären, aber auch irregulären (elektronischen) Strukturen des Bauteils bzw. der Baugruppe. Durch Abgleich mit Simulationen und/oder Referenzmustern können irreguläre Wärmequellen anhand ihrer Lage aber auch ihrer Temperaturüberhöhung eindeutig identifiziert werden.

In unserem englisch-sprachigen kostenfreien InfraTec Online-Event „*Infrared Lock-in Thermography for Inspection of Electronics and Integrated Circuits*“ erfahren Sie mehr über die Lock-In-Thermografie als bildgebendes Verfahren zur berührungslosen und zerstörungsfreien Prüfung in der Elektronik und Elektrotechnik.

Online-Event

“Infrared Lock-in Thermography for Inspection of Electronics and Integrated Circuits”

Sprache: Englisch

Einschließlich des Fachvortrags aus der Thermografiepraxis:

"Challenges and Applications of Thermography in Microelectronics"

Referent: Marko Hoffmann, Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG

Datum: Donnerstag, 9. Februar 2023 / Uhrzeit: 10:00 – 12:00 Uhr (MEZ)

Anmeldung: <https://register.gotowebinar.com/register/4571039700354773337?source=PR>

Informationen: 2.631 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Pressemitteilung

InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik

Über InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dresden. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt mehr als 240 Mitarbeiter und verfügt über eigene Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitäten.

Mit dem Geschäftsbereich Infrarot-Messtechnik zählt InfraTec zu den führenden Anbietern kommerzieller Wärmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImageIR® und der Produktfamilie VarioCAM® High Definition bietet das Unternehmen schlüsselfertige thermografische Automationslösungen u. a. für Industrieprozesse, die Qualitätssicherung oder den Bereich der Objektüberwachung.

Infrarot-Sensoren mit elektrisch durchstimmbaren Filtern auf MOEMS-Basis zählen neben spektral ein- und mehrkanaligen Infrarot-Detektoren zu den Produkten des Geschäftsbereiches Infrarot-Sensorik. Die Detektoren kommen z. B. bei der Gasanalyse, der Feuer- und Flammensensorik sowie der Spektroskopie zum Einsatz.

Pressekontakt

Firmenanschrift: InfraTec GmbH
 Infrarotsensorik und Messtechnik
 Gostritzer Str. 61 – 63
 01217 Dresden

Telefon +49 351 82876-600
Fax +49 351 82876-543
E-Mail thermo@InfraTec.de
Internet www.InfraTec.de

Bild



Online-Event: "Infrared Lock-in Thermography for Inspection of Electronics and Integrated Circuits"